



新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置：首页 > 新闻动态 > 科研动态

中科院EDA中心1053个管脚FCBGA封装顺利通过测试

2009-05-31 | 编辑： | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

由中科院EDA中心为中科院计算所互连交换芯片D5K Switch开发的1053个管脚Flipchip-BGA封装（见图1）日前顺利通过测试，该芯片用于863计划重大专项支持的曙光5000A高效能计算机。封装好的D5K Switch芯片已于09年4月16日在计算所通过DSP测试，正在进行的功能测试表明该芯片工作正常。

目前国内高端封装设计和制造能力完全掌握在外资大厂手中，而且一般只针对量产服务，小批量高端封装服务始终是业界一个重大难题。中科院EDA中心快速高端封装服务平台立足自主BGA封装设计研究，整合业界资源，采用分段加工的新流程为各科研院所和企业提供完整的小批量高端服务解决方案。在给计算所开发FCBGA封装项目中，针对芯片32组信号共1053个管脚，中科院EDA中心开发设计12层HDI BGA基板，分别委托Kyocera公司进行基板加工、ASAT公司进行Bumping and Assembly。该芯片封装是国内首款自主设计1000pin以上的FCBGA。

中科院EDA中心快速高端封装服务平台于2007年设立，为各科研院所和企业提供完善封装解决方案。07-08年已为微电子所一室院创新项目“光学读出非制冷红外阵列传感器”提供封装技术服务，制成含有铯和玻璃窗口的气密性可伐合金外壳。

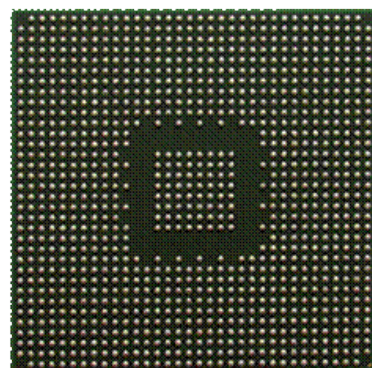
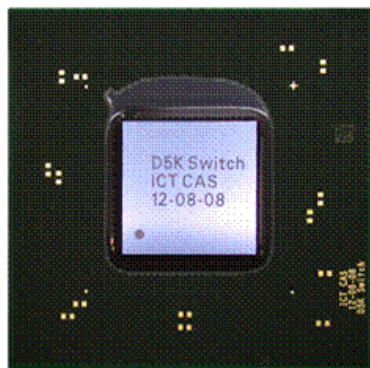


图1 1053管脚FCBGA封装的D5K Switch芯片

相关新闻:

【科学新闻】感知中国 我们集结——中科院物联网研究发展中心管窥

南京市委书记朱善璐一行访问微电子所

《芯天地》2010年第5期



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029

单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号